反应磁控溅射 Cu₂ O 薄膜的结构和电学性质

肖荣辉¹ 林丽梅² ,郑明志² ,彭福川² ,郑冬梅¹

(1. 三明学院物理与机电工程系, 福建 三明 365004; 2. 福建师范大学物理与光电信息科技学院, 福建 福州 350007)

摘要:用 X 射线衍射仪检测薄膜的结构;用分光光度计测量薄膜的透射率和反射率 采用拟合正入射透射谱数据的 方法计算薄膜的厚度;用 Van der Pauw 方法测量薄膜表面电阻和霍尔迁移率 ,并计算出电阻率和载流子浓度.结果 表明 ,生成单相 Cu₂O 薄膜的氧气流量范围很小 ,在氧气流量为 5 − 7 secm 范围 ,薄膜主要成分为 Cu₂O ,其中氧氩流 量比为 6:25 时 ,生成单相多晶结构的 Cu₂O 薄膜 ,其表面电阻 0.68 MΩ/□ ,电阻率 58.29 Ω. cm ,霍尔迁移率 4.73 cm² • V⁻¹ • s⁻¹ ,载流子浓度 3 × 10¹⁶ cm⁻³.

关键词: Cu₂O; 反应磁控溅射; 结构; 电学性质 中图分类号: 0484

文献标识码: A

文章编号: 1009-7821(2010)05-0022-04

Structural and electrical properties of Cu_2O films deposited by DC veactive magnetron sputtering

XIAO Rong-hui¹, LIN Li-mei² ZHENG Ming-zhi² PENG Fu-chuan² ZHENG Dong-mei¹

Department of Physics Mechanical and Electric engineering SanMing University Sanming, Fujian 365004, China;
 School of Physics and OptoElectronics Technology, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350007, China)

Abstract: The microstructure , surface morphology and optical transmittance of the films were investigated by X-ray diffractometer , atomic force microscopy and double-beam spectrophotometer , respectively. The electrical parameters were measured by van der Pauw method. The results indicated that the main component is Cu_2O when oxygen flows rates were between 5 and 7 sccm. When the rate of oxygen and argon flow rate is 6:25 , the single-phase polycrystalline structure of Cu_2O film has been deposited. The surface resistance , resistivity , hall mobility and carrier concentration of the Cu_2O film are 0. 68 M Ω/\Box , 58. 29 Ω . cm , 4. 73 cm² • V⁻¹ • s⁻¹ and 3 × 10¹⁶ cm⁻³ , respectively.

Key words: Cu₂O; reactive magnetron sputtering; structure; electrical properties

氧化亚铜(Cu_2O) 是一种能被可见光激发、具有立方结构^[1]、直接带隙的 P 型半导体材料^[2],其带隙约为 2.17 eV^[3]. Cu_2O 来源丰富、无毒,制备成本低廉^[2,4],在波长 600 nm 以下有高吸收的特性,具有较高的理论 光电转换效率(18% - 20%^[3,5]),是一种非常理想的太阳能光伏材料. Cu_2O 主要应用于超导体、制氢、气敏传感器^[6]、电致变色和异质结太阳能电池^[2,4]和光催化^[7]等方面.

在先前的研究中,研究人员在玻璃、石英等不同基片上,通过不同的生成模式获得 Cu₂O 薄膜.如采用热 蒸发或直接溅射铜靶,然后在不同温度、不同保护环境(氮气、氢气、大气)中进行退火的热氧化法^[1,7];或直

收稿日期: 2010-06-28

基金项目: 福建省自然科学基金资助项目(2007J0317); 福建省教育厅基金资助项目(JB08065); 福建省教育厅科技项目 (JK2009038); 三明学院科学研究发展基金资助项目(B0820/G)

作者简介:肖荣辉(1976-),男,福建宁化人,三明学院物理与机电工程系讲师. 林丽梅(1983-),女,福建莆田人,福建师范大学物理与光电信息科技学院讲师. 郑明志(1986-),男,福建莆田人,福建师范大学物理与光电信息科技学院讲师.

接溅射铜靶 采用氧氩反应模式的直流^[23468]磁控溅射法 ,或采用直接溅射 Cu₂O 靶的射频^[9] 脉冲^[10]磁控 溅射法 ,或采用醋酸盐浴的电化学沉积法^[11]等. 在这些方法中 ,直流磁控溅射法是最好的制备 Cu₂O 薄膜的 方法之一 具有沉积温度低、制备成本低廉等优点.

采用从铜靶反应磁控溅射 Cu₂O 薄膜,薄膜性质与沉积参数密切相关,而且容易产生 Cu₂O 和 CuO 的混 合结构.因此,如何精确地控制沉积参数,探寻获得高质量的单相 Cu₂O 薄膜的最佳参数配置成为研究的热 点.例如,Figueiredo^[1]等人对铜膜进行热氧化,发现不同的退火温度将生成不同的氧化物,在 200 – 300 °C 退 火时,生成物为单相 Cu₂O. Reddy^[2,4]等人研究溅射功率、溅射气压对直流磁控溅射 Cu₂O 薄膜的结构和光电 学性质的影响,在溅射功率 1.08 W·cm⁻²条件下,获得了电阻率 46 Ω·cm,霍尔迁移率 5.7 cm²·V⁻¹s⁻¹, 空穴浓度 2.4×10¹⁶ cm⁻³的单相多晶结构的 p 型 Cu₂O 薄膜;并发现在溅射气压 4 Pa 时,Cu₂O 薄膜沿(111) 方向生长,电阻率、透过率随溅射气压的上升而增加,而霍尔迁移率却相反.Pierson^[12]等人研究氧气流量对铜 氧化物的影响,发现生成单相 Cu₂O 薄膜的氧气流量范围小于 1 sccm. Chu^[8]等人研究发现直流磁控溅射时只 能在一个很小的氧分压范围内生成 P 型 Cu₂O 薄膜,并可通过改变氧分压来调节薄膜的光电学性质.

本文选择氧气流量范围为 5 – 7 sccm ,采用直流磁控溅射法制备 Cu₂O 薄膜 ,用光学拟合的方法计算薄膜 的厚度 ,分析薄膜的结构和电学特性.

1 实验

利用 JGP560B II 型超高真空磁控溅射设备,以直径 50 mm、厚度 3 mm 纯度 99.99%的铜为溅射靶材,靶 基距离 60 mm 在 K9 玻璃基片上直流反应磁控溅射沉积 Cu₂O 薄膜.实验前,玻璃基片用丙酮和无水酒精清 洗.溅射前真空腔的气压为 4.5×10⁻⁴ Pa ,氩气作为工作气体,氧气作为反应气体,流量分别用两个质量流量 控制器控制;每次沉积薄膜前,用氩离子预溅射 5 min,以清除靶表面的污染物.溅射过程中,溅射功率 90 W、 溅射气压 0.9 Pa、氩气流量 25 sccm、沉积时间 10 min,基片温度通过电加热炉和热电偶控制,加热至 200 ℃ 等参数保持不变,改变氧气流量从 5 – 7 sccm,制备 3 片 Cu₂O 薄膜样品.

用 Y2000 型 X 射线衍射(XRD) 仪(铜靶 Kα 辐射) 测量样品的结构. 用 <u>CSPM4000 型原子力显微镜</u> (AFM) 观测薄膜的表面形貌. 用 PerkinElmer Lambda 950 UV-VIS-NIR 双光束光度计测量薄膜的可见近红外 透射光谱 波长范围 400 – 2 500 nm ,采用拟合透射光谱数据的方法计算薄膜厚度(d). 用 Van der Pauw 方法 测量薄膜的方块电阻(Rs) 和霍尔迁移率(μ) ,并计算出电阻率(ρ) 和载流子浓度(Ne).

2 结果与讨论

2.1 薄膜的结构和表面形貌

图 1 为不同氧气流量条件制备薄膜的 X 射线衍 射(XRD) 谱,分析可知,氧气流量 5 sccm 时,结合薄 膜的电学性质,确定薄膜成分为 Cu₂O 和少量未经充 分氧化的非晶 Cu; 6 sccm 时,成分为单相多晶结构 的 Cu₂O,而氧气流量为 7 sccm 时,XRD 谱中虽然只 有一个衍射峰,但通过分析薄膜的可见近红外透射 谱,确定薄膜主要成分为 Cu₂O,并伴随少量的非晶 Cu₄O₃. 由此可见,氧气流量为 5 、 6 和 7 sccm 时,薄膜 在生长过程中,氧化物主要成分均为 Cu₂O(JCPDS 05 - 0667),而生成单相 Cu₂O 的氧气流量范围却很 小,与 Chu^[8]、P ierson^[12]等人的研究结果类似. 由图 1 知,样品中主要有两个衍射峰,不同晶面指数对应 的 2 θ 衍射角,晶面间距 d 和晶粒尺寸 D 由软件计算



图 1 不同氧气流量条件制备 Cu₂O 薄膜的 XRD 谱



获得,详见表 1. 结果显示 (111) 晶面衍射峰不断增强,对应的晶粒尺寸随氧气流量的增加而减小,而(200) 晶面衍射峰不断减小;随着氧气流量的增加,Cu₂O薄膜样品颜色从微淡黄色变为微淡红色. 图 2 为 5、6 scem 氧气流量条件制备 样品的原子力表面显微图像,面积为 10 × 10 μm²,由图可见,样品表面均比较致密、 平整、规则,没有明显的空洞缺陷.薄膜的 均方根(RMS)表面粗糙度和平均颗粒尺 寸由软件计算,分别为 7.51 和5.13 nm, 60.2 和 62.0 nm.随氧气流量增加,RMS 有所减小,但颗粒尺寸变化不明显.

2.2 薄膜的厚度

用基于 Forouhi-Bloomer 模型(FBM) 和修正的 Drude 自由电子模型(MDM) 相 结合的介电模型编制软件^[13],拟合薄膜透 射光谱的高透区,计算薄膜的厚度.图3为 氧气流量为5、7 sccm 时样品的测量透射 谱(实线)和拟合的透射谱(虚线),拟合范 围分别为600-2500 nm 和750-2500 nm.由图可知,拟合曲线与测量曲线符合得 很好,说明拟合得到的薄膜厚度是正确的,

3 个样品的拟合厚度分别为 1 011 858 和 763 nm.

2.3 电学性质

2.3.1 薄膜的表面电阻和电阻率

用 Van der Pauw 方法测量薄膜的表面电阻^[14]: $R_s = \frac{\pi}{\ln 2} \left[\frac{R_{23,14} + R_{34,12}}{2} \right] f(Q)$,其中 f(Q)为与 $Q = \frac{R_{23,14}}{R_{34,12}}$ 有关的修正因子,且 f(Q) = 1 - 0.346 57 $\left[\frac{Q-1}{Q+1} \right]^2 - 0.092 \ 36 \left[\frac{Q-1}{Q+1} \right]^4$,则薄膜的电阻率为 $\rho = R \ d \ d$ 为薄膜厚度. 2.3.2 薄膜的霍尔迁移率和载流子浓度 根据霍尔效应原理 旅据公式 $\mu = \frac{U_B}{R \ IB} \ N_e =$

 $\frac{1}{\rho e \mu}$,计算薄膜的霍尔迁移率 μ 和载 流子浓度 N_e ,其中 U_{μ} 为霍尔电压 μ 为测量电流 B 为垂直膜面的磁感 应强度, e 为电子电量. 通过改变电 流和磁场的方向来消除测量过程中 产生的热电热磁效应,用误差传递 函数计算各量的误差.







表1 样品不同晶面对应的 2θ 衍射角 晶面间距 d 和晶粒尺寸 D

Tab. 1 Diffraction angle (2θ) , interplanar spacing (d) and grain size (D) of samples

氧气流量	(111) 晶面			(200) 晶面		
/sccm	2 θ/(°)	d /Å	D /nm	2 θ/(°)	d /Å	D /nm
5	36.53	2.4576	21.1	42.74	2.1153	18.9
6	36.26	2.4754	17.6	42.20	2.1397	14.9
7	36.29	2.4734	10.6	—	_	—



(a) 5 scem (b) 6 scem 图 3 薄膜的测量和拟合的透射光谱

Fig. 3 Measured (solid line) and simulated (dash line) transmittance for Cu_2O films with different oxygen flows rates

表2 样品的表面电阻 R_s 、电阻率 ρ 、霍尔迁移率 μ 和载流子浓度 N_s

Tab. 2 The surface resistance ($R_{\rm s}$) , resistivity (ρ) , hall mobility (μ) and carrier concentration (Ne) of samples

$O_2/sccm$	$R_s/M\Omega/\Box$	$ ho/\Omega$ • cm	$\mu/(\mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{V}^{-1} \mathrm{S}^{-1})$	$N_s/10^{16}{ m cm}^{-3}$
5	0.04 ± 0.001	3.99 ± 0.03	1.69 ± 0.34	96.47 ± 17.03
6	0.68 ± 0.030	58. 29 ± 2. 93	4.73 ± 0.38	3.00 ± 0.39
7	0.26 ± 0.010	20. 14 \pm 1. 02	0.44 ± 0.05	78.40 \pm 10.15

为 0.68 MΩ/□, 电阻率为 58.29 Ω • cm ,霍尔迁移率为 4.73 cm² • V⁻¹s⁻¹,比 5、7 sccm 薄膜的相应值都大, 但载流子浓度 3×10¹⁶ cm⁻³却最小 ,载流子浓度随氧气流量的增加先减小而后又增加,主要是由于薄膜成分 的变化所引起.氧气流量 6 sccm 条件下制备薄膜的电学性质与 Figueiredo^[1]等人对铜膜在 200、250 ℃进行退 火时获得的 p 型 Cu₂O 薄膜的电学性质接近,也与 Reddy^[2]等人在溅射功率 1.08 W • cm⁻²条件下,获得的单 相多晶结构的 p 型 Cu₂O 薄膜的电学性质相近.

3 结论

用反应磁控溅射方法在 K9 玻璃基片上沉积不同氧气流量的 Cu₂O 薄膜. XRD、AFM、分光光度计等分别 用于检测薄膜的结构、表面形貌和透射谱,用 FBM + MDM 相结合的介电模型编制软件 对正入射透射光谱进 行拟合,计算薄膜的厚度,Van der Pauw 方法用于测量薄膜的电学性质. 结果表明,生成单相 Cu₂O 薄膜的氧 气流量范围很小,在氧气流量为 5 – 7 sccm 范围,薄膜主要成分为 Cu₂O. 当氧氩流量比为 6:25 时,生成单相 多晶结构的 Cu₂O 薄膜,其表面电阻为 0.68 MΩ/□ 电阻率为 58.29 Ω • cm 霍尔迁移率为 4.73 cm² • V⁻¹s⁻¹, 载流子浓度为 3 × 10¹⁶ cm⁻³.

参考文献:

- [1] Figueiredo V, Elangovan E, Goncalves G, et al. Effect of post annealing on the properties of copper oxide thin films obtained from the oxidation of evaporated metallic copper [J]. Appl Surf Sci , 2008 , 254 (13): 3 949 – 3 954.
- [2] Reddy A S, Park H H, Reddy V S, et al. Effect of sputtering power on the physical properties of dc magnetron sputtered copper oxide thin films [J]. Mater Chem Phys , 2008 , 110 (2/3): 397 - 401.
- [3] Hsieh J H , Kuo P W , Peng K C , et al. Opto electronic properties of sputter deposited Cu₂O films treated with rapid thermal annealing [J]. Thin Solid Films , 2008 , 516 (16) : 5 449 5 453.
- [4] Reddy A S, Uuthanna S, Reddy P S. Properties of dc magnetron sputtered Cu₂O films prepared at different sputtering pressures
 [J]. Appl Surf Sci , 2007 , 253 (12): 5 287 5 292.
- [5] Ghosh S, Avsthi D K, Shah P, et al. Deposition of thin films of different oxides of copper by RF reactive sputtering and their characterization [J]. Vacuum, 2000, 57 (4): 377 – 385.
- [6] Reddy A S, Venkata R G, Uthana S, et al. Structural and optical studies on dc reactive magnetron sputtered Cu₂O films [J]. Mater Lett, 2006, 60 (13/14): 1 617 – 1 621.
- [7] Jayatissa A H, Guo K. Jayasuriva A C. Fabrication of cuprous and cupric oxide thin films by heat treatment [J]. Appl Surf Sci , 2009, 255 (23): 9 474 – 9 479.
- [8] Chu Chun Lung , LU Hsin Chun , LO Chen Yang , et al. Physical properties of copper oxide thin films prepared by dc reactive magnetron sputtering under different oxygen partial pressures [J]. Physica B , 2009 , 404(23/24): 4 831 4 834.
- [9] Yang W Y, Kim W G, Rhee S W. Radio frequency sputter deposition of single phase cuprous oxide using Cu₂O as a target material and its resistive switching properties [J]. Thin Solid Films , 2008, 517 (2): 967-971.
- [10] Alkoy E M, Kelly P J. The structure and properties of copper oxide and copper aluminium oxide coatings prepared by pulsed magnetron sputtering of powder targets [J]. Vacuum, 2005, 79 (3/4): 221-230.
- [11] Wijesundera R P, Hidaka M, Koga K et al. Growth and characterisation of potentiostatically electrodeposited Cu₂O and Cu thin films [J]. Thin Solid Films ,2006 ,500 (1/2): 241 – 246.
- [12] Pierson J F, Thobor Keck A, Billard A. Cuprite, paramelaconite and tenorite films deposited by reactive magnetron sputtering
 [J]. Appl Surf Sci, 2003, 210 (3/4): 359 367.
- [13] Lai F C , Lin L M , Gai R Q , et al. Determination of optical constants and thicknesses of In₂O₃: Sn films from transmittance data
 [J]. Thin Solid Films , 2007 , 515 (18) : 7 387 7 392.
- [14] 林丽梅 赖发春 林永钟 等. 热处理对直流磁控溅射 ITO 薄膜光电学性质的影响 [J]. 福建师范大学学报: 自然科学版, 2006 22(3):42-46.

(责任编辑:金甦)